#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-27001 (P2003-27001A)

(43)公開日 平成15年1月29日(2003.1.29)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FI	テーマコード(参考)			
C 0 9 D 183/04		C 0 9 D 183/04	4D075			
B05D 7/24	302	B05D 7/24	302Y 4J002			
CO8L 83/04		C08L 83/04	4 J 0 3 8			
83/08	•	83/08	5 F 0 5 8			
C 0 9 D 183/02		C 0 9 D 183/02				
·	審査請求	未請求 請求項の数6 〇	L (全 15 頁) 最終頁に続く			
(21)出願番号	特顧2001-215010(P2001-215010)	(71)出願人 000004178	アール株式会社			
(22)出顧日	平成13年7月16日(2001.7.16)					
( <i>62)</i> (1184 D	TM104 / 7110   (2001: 1:10)	(72)発明者 篠田 智隆				
		' ' ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - '	: 			
		スアール格				
		(72)発明者 杉浦 誠	MAH!			
		1	区築地二丁目11番24号ジェイエ			
		スアール株				
		(72)発明者 吉岡 睦彦				
			・  区築地二丁目11番24号ジェイエ			
		スアール株	TAMETERS.			
			最終頁に続く			

### (54) 【発明の名称】 膜形成用組成物、膜の形成方法およびシリカ系膜

#### (57)【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、低比誘電率、高弾性率の塗膜が得られ、かつワニスを長期保存しても異物の発生の少ない膜形成用組成物を得る。

【整理番号】

9360

【解決手段】 (A)アルコキシシランを金属キレート化合物および酸触媒もしくはいずれか一方と水の存在下で加水分解、縮合して得られる加水分解縮合物、

(B) アルコキシシランをアルカリ触媒と水の存在下で加水分解、縮合して得られる加水分解縮合物、(C) 有機溶剤ならびに(D) 水を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)下記一般式(1)で表される化 · 合物、下記一般式(2)で表される化合物および下記一 般式(3)で表される化合物からなる群から選ばれた少 なくとも1種の化合物を金属キレート化合物および酸触 媒もしくはいずれか一方と水の存在下で加水分解、縮合 して得られる加水分解縮合物、(B)下記一般式(1) で表される化合物、下記一般式(2)で表される化合物 および下記一般式 (3) で表される化合物からなる群か\*

1

 $R_b^4$  (R'O)<sub>3-b</sub> Si - (R')<sub>4</sub> - Si (OR')<sub>3-c</sub> R'<sub>c</sub> · · (3)

〔式中、R'~R'は同一または異なり、それぞれ1価の 有機基、b~cは同一または異なり、0~2の整数、R \*は酸素原子、フェニレン基または-(CH、)。-で表 される基(CCC、nは1~6の整数である)、dは0 または1を示す。〕

【請求項2】 (C)成分100重量部に対して (D) 成分が2~15重量部含有されることを特徴とす る請求項1記載の膜形成用組成物。

(A)成分に対する(B)成分の使用 【請求項3】 換算) に対して(B) 成分5~95重量部(完全加水分 解縮合物換算) であることを特徴とする請求項1記載の 膜形成用組成物。

(C) 成分が下記一般式(4)で表 【請求項4】 される有機溶剤であることを特徴とする請求項1記載の 膜形成用組成物。

R,O (R,10),R,0  $\cdots \cdots (4)$ 

(R°およびR¹°は、それぞれ独立して水素原子、炭素 数1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる 1価の有機基を示し、R11はアルキレン基を示し、eは 30 1~2の整数を表す。)

【請求項5】 請求項1項記載の膜形成用組成物を基 板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法。

【請求項6】 請求項5記載の膜の形成方法によって 得られるシリカ系膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 緑膜材料として、低比誘電率、高弾性率の塗膜が得ら れ、かつワニスを長期保存しても異物の発生の少ない膜 形成用組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ リカ(SiO。)膜が多用されている。そして、近年、 より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、S OG (Spin on Glass) 膜と呼ばれるテトラアルコキ シランの加水分解生成物を主成分とする塗布型の絶縁膜 も使用されるようになっている。また、半導体素子など 50 R。Si(OR<sup>2</sup>),... ・・・・・(1)

\* ら選ばれた少なくとも1種の化合物をアルカリ触媒と水 の存在下で加水分解、縮合して得られる加水分解縮合 物、(C)有機溶剤ならびに(D)水を含有することを 特徴とする膜形成用組成物。

R. Si (OR') ...  $\cdots \cdots (1)$ 

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。)  $\cdots (2)$ Si (OR'),

(式中、R'は1価の有機基を示す。)

の高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポリオルガノ シロキサンを主成分とする低比誘電率の層間絶縁膜が開 発されている。特に半導体素子などのさらなる髙集積化 や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶縁性が要求 されており、したがって、より低比誘電率の層間絶縁膜 材料が求められるようになっている。

【0003】低比誘電率の材料としては、アンモニアの 存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子と アルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物か 割合が、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物 20 らなる組成物(特開平5-263045、同5-315 319)や、ポリアルコキシシランの塩基性加水分解物 をアンモニアの存在下縮合することにより得られた塗布 液(特開平11-340219、同11-34022 0)が提案されているが、これらの方法で得られる材料 は、反応の生成物の性質が安定せず、低比誘電率や高弾 性率の塗膜が得られ難く、材料の保存時に異物が発生す るなど、工業的生産には不向きであった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しく は、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、低比誘 電率、高弾性率の塗膜が得られ、かつワニスを長期保存 しても異物の発生の少ない膜形成用組成物および該組成 物から得られるシリカ系膜を提供することを目的とす る。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)下記一 般式(1)で表される化合物、下記一般式(2)で表さ れる化合物および下記一般式(3)で表される化合物か らなる群から選ばれた少なくとも 1 種の化合物を金属キ レート化合物および酸触媒もしくはいずれか一方と水の 存在下で加水分解、縮合して得られる加水分解縮合物、

- (B) 下記一般式(1) で表される化合物、下記一般式 (2)で表される化合物および下記一般式(3)で表さ れる化合物からなる群から選ばれた少なくとも1種の化 合物をアルカリ触媒と水の存在下で加水分解、縮合して 得られる加水分解縮合物(C)有機溶剤ならびに(D) 水を含有することを特徴とする膜形成用組成物に関す る。

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R'は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) \*

 $R_b^* (R'O)_{3-b} Si - (R')_{4} - Si (OR')_{3-c} R'_{c} \cdot \cdot \cdot (3)$ 

[式中、R'~R'は同一または異なり、それぞれ1価の 有機基、b~cは同一または異なり、0~2の整数、R ®は酸素原子、フェニレン基または- (CH、)。-で表 される基(CCで、nは1~6の整数である)、dは0 または1を示す。〕

次に、本発明は、上記膜形成用組成物を基板に塗布し、 加熱することを特徴とする膜の形成方法に関する。次 に、本発明は、上記膜の形成方法によって得られるシリ カ系膜に関する。

#### [0006]

【発明の実施の形態】本発明において、(A)成分およ び(B)成分の加水分解縮合物とは、上記化合物(1) ~(3)の群から選ばれた少なくとも1種の加水分解物 および縮合物もしくはいずれか一方である。ここで、 (A)成分および(B)成分における加水分解物とは、 上記(A)成分および(B)成分の加水分解縮合物を構 成する化合物(1)~(3) に含まれるR'O-基、R 3 O-基、R'O-基およびR'O-基のすべてが加水 分解されている必要はなく、例えば、1個だけが加水分 解されているもの、2個以上が加水分解されているも の、あるいは、これらの混合物であってもよい。また、 (A)成分および(B)成分における縮合物は、(A) 成分および(B)成分を構成する化合物(1)~(3) の加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si 結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール 基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラ

ノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているも 30

### のの混合物などをも包含した概念である。 [0007] (A) 成分および (B) 成分

【0008】化合物(1);上記一般式(1)におい て、RおよびR'の1価の有機基としては、アルキル 基、アリール基、アリル基、グリシジル基などを挙げる ととができる。また、一般式(1)において、Rは1価 の有機基、特にアルキル基またはフェニル基であること が好ましい。ここで、アルキル基としては、メチル基、 エチル基、プロビル基、ブチル基などが挙げられ、好ま しくは炭素数1~5であり、これらのアルキル基は鎖状 40 でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原 子などに置換されていてもよい。一般式(1)におい て、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メ チルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル 基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げ ることができる。

【0009】一般式(1)で表される化合物の具体例と しては、フルオロトリメトキシシラン、フルオロトリエ トキシシラン、フルオロトリーn-プロポキシシラン、

\*Si (OR3).  $\cdots (2)$ (式中、R'は1価の有機基を示す。)

リーn-ブトキシシラン、フルオロトリーsec-ブト キシシラン、フルオロトリーtertーブトキシシラ ン、フルオロトリフェノキシシランなど;メチルトリメ トキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリ -n-プロポキシシラン、メチルトリーiso-プロポ キシシラン、メチルトリ-n-ブトキシシラン、メチル 10 トリーsec‐ブトキシシラン、メチルトリーtert ブトキシシラン、メチルトリフェノキシシラン、エチ ルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エ チルトリーn-プロポキシシラン、エチルトリーiso -プロポキシシラン、エチルトリ-n-ブトキシシラ ン、エチルトリーsec-ブトキシシラン、エチルトリ -tert-プトキシシラン、エチルトリフェノキシシ ラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシ シラン、ビニルトリーn-プロポキシシラン、ビニルト リーiso-プロポキシシラン、ビニルトリーn-ブト 20 キシシラン、ピニルトリーsec‐ブトキシシラン、ビ ニルトリーtert-プトキシシラン、ビニルトリフェ ノキシシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラン、n-プロピルトリーn-プロポキシシラン、n-プロピルトリーiso-プロポ キシシラン、n-プロピルトリ-n-ブトキシシラン、 n-プロピルトリーsec-ブトキシシラン、n-プロ ピルトリーtert‐プトキシシラン、n‐プロピルト リフェノキシシラン、i-プロピルトリメドキシシラ ン、i-プロピルトリエトキシシラン、i-プロピルト リーnープロポキシシラン、iープロピルトリーiso -プロポキシシラン、i-プロピルトリーn-ブトキシ シラン、iープロピルトリーsecーブトキシシラン、 i-プロピルトリーtert-ブトキシシラン、i-プ ロビルトリフェノキシシラン、n-ブチルトリメトキシ シラン、n-ブチルトリエトキシシラン、n-ブチルト リーnープロポキシシラン、nープチルトリーisoー プロポキシシラン、nーブチルトリーnーブトキシシラ ン、n-ブチルトリーsec-ブトキシシラン、n-ブ チルトリーtert‐ブトキシシラン、n‐ブチルトリ フェノキシシラン、sec-ブチルトリメトキシシラ ン、sec‐ブチルトリエトキシシラン、sec‐ブチ ルートリーnープロポキシシラン、secーブチルート リーiso-プロポキシシラン、sec-ブチルートリ -n-ブトキシシラン、sec-ブチル-トリーsec -ブトキシシラン、sec-ブチルートリーtert-ブトキシシラン、sec‐ブチル‐トリフェノキシシラ ン、t-ブチルトリメトキシシラン、t-ブチルトリエ トキシシラン、t-ブチルトリ-n-プロポキシシラ ン、t-ブチルトリーiso-プロポキシシラン、t-フルオロトリーiso-プロポキシシラン、フルオロト 50 ブチルトリーn-ブトキシシラン、t-ブチルトリーs

ecーブトキシシラン、tーブチルトリーtertーブ トキシシラン、t-ブチルトリフェノキシシラン、フェ ニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラ ン、フェニルトリーn-プロポキシシラン、フェニルト リーisoープロポキシシラン、フェニルトリーnーブ トキシシラン、フェニルトリーSec‐ブトキシシラ ン、フェニルトリーtert-プトキシシラン、フェニ ルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、 ピニルトリエトキシシラン、ケーアミノプロピルトリメ トキシシラン、ァーアミノプロビルトリエトキシシラ ン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ア – グリシドキシプロビルトリエトキシシラン、γートリ フロロプロピルトリメトキシシラン、ャートリフロロブ ロピルトリエトキシシランなど;

【0010】ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエ トキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシラン、 ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメチルー ジーn-ブトキシシラン、ジメチル-ジーsec-ブト キシシラン、ジメチルージーtert-ブトキシシラ ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ 20 メチルトリーnープロポキシシラン、メチルトリーis シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージーn ープロポキシシラン、ジエチルージーisoープロポキ シシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジエチ ルージーsecーブトキシシラン、ジエチルージーte rtーブトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、 ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピル ジエトキシシラン、ジーnープロピルージーnープロボ キシシラン、ジーnープロピルージーisoープロポキ シシラン、ジーnープロピルージーnーブトキシシラ ン、ジーn-プロピル-ジ-sec-プトキシシラン、 ジーn-プロピルージーtert-ブトキシシラン、ジ -n-プロピルージーフェノキシシラン、ジーiso-プロビルジメトキシシラン、ジーiso-プロビルジェ トキシシラン、ジーiso-プロビル-ジ-n-プロボ キシシラン、ジーiso-プロピルージーiso-プロ ポキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-ブトキ シシラン、ジーisoープロピルージーsecープトキ シシラン、ジーisoープロピルージーtertープト キシシラン、ジーiso-プロピル-ジ-フェノキシシ ラン、ジ-n-ブチルジメトキシシラン、ジ-n-ブチ 40 ルジエトキシシラン、ジーnープチルージーnープロボ キシシラン、ジーn-ブチル-ジ-iso-プロポキシ シラン、ジーnープチルージーnーブトキシシラン、ジ -n-ブチルージーsec-ブトキシシラン、ジーn-プチルージーtertーブトキシシラン、ジーnープチ ルージーフェノキシシラン、ジーSec-ブチルジメト キシシラン、ジーsec‐ブチルジェトキシシラン、ジ -sec-ブチルージ-n-プロポキシシラン、ジーs ec-ブチルージーiso-プロポキシシラン、ジーs ecーブチルージーnーブトキシシラン、ジーsecー 50 ーペンタエトキシー3ーエチルジシロキサン、1, 1,

ブチルージーSecーブトキシシラン、ジーSecーブ チルージーtert-ブトキシシラン、ジーsec-ブ

チルージーフェノキシシラン、ジーtertープチルジ メトキシシラン、ジーtert-ブチルジエトキシシラ ン、ジーtert-ブチルージーn-プロポキシシラ ン、ジーtert-ブチルージーiso-プロポキシシ ラン、ジーtertープチルージーnーブトキシシラ ン、ジーtert-ブチルージーsec-ブトキシシラ ン、ジーtert-ブチル-ジ-tert-ブトキシシ 10 ラン、ジーtert‐ブチルージーフェノキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ シシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラン、ジ フェニルージーisoープロポキシシラン、ジフェニル -ジーn-ブトキシシラン、ジフェニル-ジーsec-プトキシシラン、ジフェニルージーtert-プトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビニルトリ メトキシシランなど;を挙げることができる。

【0011】化合物(1)として好ましい化合物は、メ チルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、 o-プロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エ チルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、 ピニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ ン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシ シラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキ シシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメ トキシシラン、ジフェニルジエトキシシランなどであ る。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用して もよい。

【0012】化合物(2);上記一般式(1)におい て、R<sup>3</sup> で表される1価の有機基としては、先の一般式 (1) と同様な有機基を挙げることができる。一般式 (2)で表される化合物の具体例としては、テトラメト キシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーn-プロ ポキシシラン、テトラーiso-プロポキシシラン、テ トラーnープトキシラン、テトラーsecープトキシシ ラン、テトラーtert‐ブトキシシラン、テトラフェ ノキシシランなどが挙げられる。

【0013】化合物(3);上記一般式(3)におい て、R'~R'で表される1価の有機基としては、先の 一般式(2)と同様な有機基を挙げることができる。一 般式(3)のうち、R°が酸素原子の化合物としては、 ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキ サン、ヘキサフェノキシジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタメトキシ-3-メチルジシロキサン、 1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ-3-メチルジシ ロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシー3 ーメチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ベンタメ トキシー3-エチルジシロキサン、1,1,1,3,3

7

(5)

1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3-エチルジシロキサ ン、1、1、1、3、3-ペンタメトキシー3-フェニ ルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ -3-フェニルジシロキサン、1,1,1,3,3-ベ ンタフェノキシー3ーフェニルジシロキサン、1,1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサ ン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジメチ ルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー 1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テト ラメトキシー1,3-ジエチルジシロキサン、1,1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジエチルジシロキサ ン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシ-1, 3-ジェ チルジシロキサン、1、1、3、3-テトラメトキシー 1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テ トラエトキシー1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシ-1, 3-ジフェニルジ シロキサン、1,1,3-トリメトキシー1,3,3-トリメチルジシロキサン、1,1,3-トリエトキシー 1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1, 3-ト リフェノキシー1、3、3-トリメチルジシロキサン、 1、1、3-トリメトキシ-1、3、3-トリエチルジ シロキサン、、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3 ートリエチルジシロキサン、、1,1,3ートリフェノ キシ-1, 3, 3-トリエチルジシロキサン、、1, 1, 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリフェニルジシ ロキサン、1、1、3-トリエトキシ-1、3、3-ト リフェニルジシロキサン、1,1,3-トリフェノキシ -1,3,3-トリフェニルジシロキサン、1,3-ジ メトキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサ ン、1, 3ージエトキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチ 30 ートリメチルジシラン、1, 1, 2ートリメトキシー ルジシロキサン、1,3-ジフェノキシ-1,1,3, 3-テトラメチルジシロキサン、1,3-ジメトキシー 1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1, 3-ジエトキシー1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサ ン、1, 3-ジフェノキシ-1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1,3-ジメトキシー1,1,3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1,3-ジエトキシ -1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1, 3-ジフェノキシー1、1、3、3-テトラフェニルジ シロキサンなどを挙げることができる。

【0014】 これらのうち、 ヘキサメトキシジシロキサ ン、ヘキサエトキシジシロキサン、1, 1, 3, 3-テ トラメトキシー1,3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラエトキシー1, 3-ジメチルジシロ キサン、1, 1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジ フェニルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジエトキ シー1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジメトキシー1、1、3、3-テトラフェニルジシ ロキサン、1, 3-ジェトキシー1, 1, 3, 3-テト 50 【0016】 これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、

ラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げ ることができる。

【0015】また、一般式(3)において、dが0の化 合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキ シジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1.1.1. 1, 1, 2, 2-ペンタエトキシ-2-メチルジシラ ン、1,1,1,2,2-ペンタフェノキシー2-メチ ルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシー2 10 - エチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2 - ペンタエトキ シー2-エチルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ベンタ フェノキシー2-エチルジシラン、1,1,1,2,2 ーペンタメトキシー2-フェニルジシラン、1,1, 1, 2, 2-ペンタエトキシー2-フェニルジシラン、 1, 1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシー2-フェニル ジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1,1,2,2-テトラエトキシー 1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフ ェノキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2 ーテトラメトキシー1,2-ジェチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシ-1, 2-ジエチルジシラ ン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシー<math>1, 2-ジェチルジシラン、1,1,2,2-テトラメトキシー1. 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエト キシー1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシー1、2-ジフェニルジシラン、1、 1, 2-トリメトキシ-1, 2, 2-トリメチルジシラ ン、1, 1, 2-トリエトキシ-1, 2, 2-トリメチ ルジシラン、1, 1, 2-トリフェノキシー1, 2, 2 1, 2, 2-トリエチルジシラン、、1, 1, 2-トリ エトキシー1、2、2-トリエチルジシラン、、1、 1, 2-トリフェノキシー1, 2, 2-トリエチルジシ ラン、、1, 1, 2-トリメトキシ-1, 2, 2-トリ フェニルジシラン、1、1、2-トリエトキシー1. 2, 2-トリフェニルジシラン、、1, 1, 2-トリフ ェノキシー1, 2, 2-トリフェニルジシラン、1, 2 -ジメトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチルジシラ ン、1、2-ジエトキシ-1、1、2、2-テトラメチ 40 ルジシラン、1, 2-ジフェノキシー1, 1, 2, 2- ' テトラメチルジシラン、1,2-ジメトキシ-1,1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジェトキシー 1, 1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジフ x / + v - 1, 1, 2, 2 - テトラエチルジシラン、 1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニル ジシラン、1, 2-ジエトキシ-1, 1, 2, 2-テト ラフェニルジシラン、1、2-ジフェノキシー1、1、 2, 2-テトラフェニルジシランなどを挙げるととがで きる。

ヘキサエトキシジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメト キシ-1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テ トラエトキシー1,2-ジメチルジシラン、1,1, 2. 2-テトラメトキシー1, 2-ジフェニルジシラ ン、1、2-ジメトキシ-1、1、2、2-テトラメチ ルジシラン、1,2-ジェトキシ-1,1,2,2-テ トラメチルジシラン、1,2-ジメトキシ-1,1, 2、2-テトラフェニルジシラン、1,2-ジエトキシ -1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシランなどを、好 ましい例として挙げることができる。

【0017】さらに、一般式(3)において、R°が-(CH, )。-で表される基の化合物としては、ビス (トリメトキシシリル) メタン、ピス(トリエトキシシ リル) メタン、ピス(トリーnープロポキシシリル)メ タン、ビス(トリー i -プロポキシシリル)メタン、ビ ス (トリーnープトキシシリル) メタン、ピス (トリー sec-ブトキシシリル) メタン、ビス(トリーt-ブ トキシシリル) メタン、1,2-ピス(トリメトキシシ リル) エタン、1、2-ビス (トリエトキシシリル) エ タン、1,2-ピス(トリ-n-プロポキシシリル)エ 20 3-ピス(トリ-i-プロポキシシリル)ベンゼン、 タン、1,2-ピス(トリーi-プロポキシシリル)エ タン、1,2-ピス(トリーn-ブトキシシリル)エタ ン、1,2-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)エ タン、1,2-ピス(トリーt-ブトキシシリル)エタ ン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメト キシシリル) メタン、1-(ジエトキシメチルシリル) -1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジ-n-プロポキシメチルシリル) -1-(トリ-n-プロポキ シシリル) メタン、1 - (ジ-i-プロポキシメチルシ リル)-1-(トリーi-プロポキシシリル)メタン、 1-(ジ-n-ブトキシメチルシリル)-1-(トリー n-ブトキシシリル) メタン、1-(ジ-sec-ブト キシメチルシリル) -1-(トリ-sec-ブトキシシ リル) メタン、1 - (ジ-t-ブトキシメチルシリル) -1-(トリーt-ブトキシシリル)メタン、1-(ジ メトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリ エトキシシリル) エタン、1-(ジ-n-プロポキシメ チルシリル) -2-(トリーn-プロポキシシリル) エ タン、1-(ジ-i-プロポキシメチルシリル)-2- 40 (トリーi-プロポキシシリル) エタン、1-(ジーn **-ブトキシメチルシリル)-2-(トリ-n-ブトキシ** シリル) エタン、1-(ジ-sec-ブトキシメチルシ リル)-2-(トリーsec-ブトキシシリル)エタ ン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル)-2-(ト リー t - ブトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメ チルシリル)メタン、ビス(ジエトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジ-n-プロポキシメチルシリル) メタ ン、ビス (ジーi-プロポキシメチルシリル) メタン、 ビス (ジーn-ブトキシメチルシリル) メタン、ビス

10 (ジ-sec-ブトキシメチルシリル) メタン、ピス (ジーt-ブトキシメチルシリル) メタン、1,2-ビ ス (ジメトキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジエトキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス(ジ -n-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ピス (ジーi-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ピス (ジーn-プトキシメチルシリル) エタン、1,2 - ピス (ジ-sec-ブトキシメチルシリル) エタン、 1. 2-ビス (ジーt-ブトキシメチルシリル) エタ 10 ン、1,2-ピス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 2 **- ピス(トリーn-プロポキシシリル)ベンゼン、1,** 2-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1.2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,2-ビス(トリ-t- ブトキシシリル)ベンゼ ン、1、3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,3 ービス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼン、1, 1、3-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1, 3-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,3-ビス(トリーt-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1、4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 4 ービス(トリーn-プロポキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1, 4-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,4-ビス(トリーt-ブトキシシリル)ベンゼ ンなど挙げることができる。

【0018】 これらのうち、ピス (トリメトキシシリ ル) メタン、ピス(トリエトキシシリル) メタン、1, 2-ビス (トリメトキシシリル) エタン、1,2-ビス (トリエトキシシリル) エタン、1-(ジメトキシメチ ルシリル)-1-(トリメトキシシリル)メタン、1-(ジエトキシメチルシリル) -1-(トリエトキシシリ ル) メタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-2-(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチ ルシリル) -2-(トリエトキシシリル) エタン、ピス (ジメトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジエトキシ メチルシリル) メタン、1,2-ビス(ジメトキシメチ ルシリル) エタン、1,2-ビス(ジエトキシメチルシ リル) エタン、1,2-ビス(トリメトキシシリル)べ ンゼン、1,2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼ ン、1、3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,4 - ビス (トリメトキシシリル) ベンゼン、1,4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼンなどを好ましい例とし 50 て挙げることができる。本発明において、(A)成分お

よび(B)成分を構成する化合物(1)~(3)として は、上記化合物(1)、(2) および(3) の1 種もし くは2種以上を用いることができる。

【0019】なお、上記(A)成分および(B)成分を 構成する化合物(1)~(3)の群から選ばれた少なく とも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させる際に、 化合物(1)~(3)1モル当たり0.5モルを越え1 50モル以下の水を用いることが好ましく、0.5モル を越え130モルの水を加えることが特に好ましい。添 加する水の量が0.5モル以下であると塗膜の耐クラッ ク性が劣る場合があり、150モルを越えると加水分解 および縮合反応中のポリマーの析出やゲル化が生じる場 合がある。

【0020】本発明の(A)および(B)成分の加水分 解縮合物を製造するに際しては、上記化合物(1)~ (3) の群から選ばれた少なくとも1種のシラン化合物 を加水分解、縮合させる際に、触媒を用いることが特徴 である。(A)成分の加水分解縮合物の製造の際には、 金属キレート化合物および/または酸触媒、(B)成分 の加水分解縮合物の製造の際には、アルカリ触媒を使用 20

【0021】金属キレート化合物としては、例えば、ト リエトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ト リーn-プロポキシ・モノ(アセチルアセトナート)チ タン、トリーi-プロポキシ・モノ(アセチルアセトナ ート) チタン、トリーn-プトキシ・モノ(アセチルア セトナート) チタン、トリーSec-ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーtーブトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーn - プロポ 30 キシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーi-プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジ -n-ブトキシ・ビス(アセチルアセトナート)チタ ン、ジーsec-ブトキシ・ピス (アセチルアセトナー ト) チタン、ジーt-ブトキシ・ピス(アセチルアセト ナート) チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセ トナート) チタン、モノーn-プロポキシ・トリス (ア セチルアセトナート) チタン、モノーi-プロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーnーブ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノ 40 -sec-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノー t ープトキシ・トリス (アセチルアセト ナート) チタン、テトラキス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、トリーn-プロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) チタン、トリーi-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーn-プトキ シ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーs ec-ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタ ン、トリーt-ブトキシ・モノ(エチルアセトアセテー 50 (エチルアセトアセテート)ジルコニウム、トリーt-

12 ト) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジ-n-プロポキシ・ピス (エチルアセト アセテート) チタン、ジー i - プロポキシ・ビス (エチ ルアセトアセテート) チタン、ジーn -ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーSec‐ブト キシ・ピス (エチルアセトアセテート) チタン、ジー t - ブトキシ・ピス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノ-n-プロポキシ・トリス(エチルアセトアセ 10 テート) チタン、モノーi-プロポキシ・トリス (エチ ルアセトアセテート) チタン、モノーn-ブトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) チタン、モノーSec - ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノー t - プトキシ・トリス (エチルアセトアセテ ート) チタン、テトラキス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチル アセトアセテート) チタン、ビス (アセチルアセトナー ト) ビス (エチルアセトアセテート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) チタンなどのチタンキレート化合物: トリエトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリー n-プロポキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーi-プロポキシ・モノ(アセチルアセト ナート) ジルコニウム、トリーn-ブトキシ・モノ (ア セチルアセトナート) ジルコニウム、トリーsecーブ トキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、 トリー t - ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジ ルコニウム、ジエトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジ-n-プロポキシ・ピス (アセチ ルアセトナート) ジルコニウム、ジー i - プロポキシ・ ピス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーn-ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ・ ム、ジーsec-プトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジーt-ブトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノーnープ ロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノーi-プロポキシ・トリス(アセチルアセトナ ート) ジルコニウム、モノ-n-プトキシ・トリス (ア セチルアセトナート) ジルコニウム、モノーsec-ブ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノー t - ブトキシ・トリス (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリエトキシ・モノ (エチルアセト アセテート) ジルコニウム、トリーn - プロポキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリーi - プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、トリーn-ブトキシ・モノ (エチルアセトアセ テート) ジルコニウム、トリーsec - ブトキシ・モノ

ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウ ム、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、ジーn-プロポキシ・ピス(エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジー i - プロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーn-ブ トキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウ ム、ジーsec‐ブトキシ・ピス(エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ジー t - プトキシ・ビス (エチル アセトアセテート) ジルコニウム、モノエトキシ・トリ **ープロポキシ・トリス(エチルアセトアセテート)ジル** コニウム、モノーi-プロポキシ・トリス (エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、モノーn-ブトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー sec-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー t - プトキシ・トリス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、テトラキス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、モノ (アセチルアセト ナート) トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウ ム、ビス(アセチルアセトナート)ビス(エチルアセト アセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナ ート) モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウムな どのジルコニウムキレート化合物;トリス(アセチルア セトナート) アルミニウム、トリス (エチルアセトアセ テート) アルミニウムなどのアルミニウムキレート化合 物;などを挙げることができ、好ましくはチタンおよび /またはアルミのキレート化合物。特に好ましくはチタ ンのキレート化合物を挙げることができる。これらの金 属キレート化合物は、1種あるいは2種以上を同時に使 用しても良い。

13

【0022】酸触媒としては、例えば、塩酸、硝酸、硫 酸、フッ酸、リン酸、ホウ酸、シュウ酸などの無機酸; 酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン 酸、ヘプタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シ ュウ酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セ バシン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン 酸、シキミ酸、2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ス テアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、 安息香酸、pーアミノ安息香酸、pートルエンスルホン 酸、ベンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢 酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン 酸、スルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石 酸、コハク酸、イタコン酸、メサコン酸、シトラコン 酸、リンゴ酸、グルタル酸の加水分解物、無水マレイン 酸の加水分解物、無水フタル酸の加水分解物などの有機 酸を挙げることができ、有機酸をより好ましい例として 挙げることができる。これら化合物は、1種あるいは2 種以上を同時に使用してもよい。

【0023】アルカリ触媒としては、例えば、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、ピリジ

ン、ピロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、 ピコリン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミ ン、ジメチルモノエタノールアミン、モノメチルジエタ ノールアミン、トリエタノールアミン、ジアザビシクロ オクタン、ジアザビシクロノナン、ジアザビシクロウン デセン、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイ ド、テトラエチルアンモニウムハイドロオキサイド、テ トラプロピルアンモニウムハイドロオキサイド、テトラ ブチルアンモニウムハイドロオキサイド、アンモニア、 ス(エチルアセトアセテート)ジルコニウム、モノーn 10 メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチル アミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、ペンチルア ミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、 N. N-ジメチルアミン、N, N-ジエチルアミン、 N. N-ジプロピルアミン、N. N-ジブチルアミン、 トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルア ミン、トリブチルアミン、シクロヘキシルアミン、トリ メチルイミジン、1-アミノ-3-メチルブタン、ジメ チルグリシンなどを挙げることができ、より好ましくは 有機アミンであり、アンモニア、アルキルアミンおよび 20 テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドがシリカ 系膜の基板への密着性の点から特に好ましい。これらの アルカリ触媒は1種あるいは2種以上を同時に使用して も良い。

> (3) 中のR'O-基, R'O-基, R'O-基および R°O-基で表される基の総量1モルに対して、通常、 0.00001~10モル、好ましくは0.00005 ~5 モルである。触媒の使用量が上記範囲内であれば、 反応中のボリマーの析出やゲル化の恐れが少ない。 【0025】本発明において(A)成分および(B)成 30 分中、各成分を完全加水分解縮合物に換算したときに、 化合物(2)は、化合物(1)~(3)の総量中、5~ 75重量%、好ましくは10~70重量%、さらに好ま しくは15~70重量%である。また、化合物(1)お よび/または(3)は、化合物(1)~(3)の経量 中、95~25重量%、好ましくは90~30重量%、 さらに好ましくは85~30重量%である。化合物 (2)が、化合物(1)~(3)の総量中、5~75重 量%であることが、得られる塗膜の弾性率が高く、かつ 低誘電性に特に優れる。ととで、本発明において、完全 加水分解縮合物とは、化合物(1)~(3)中のR<sup>1</sup> O -基、R'O-基, R'O-基およびR'O-基が10 0%加水分解してSiOH基となり、さらに完全に縮合 してシロキサン構造となったものをいう。また、(A) 成分および(B)成分としては、得られる組成物の貯蔵 安定性がより優れるので、化合物(1)および化合物 (2)の加水分解縮合物であることが好ましい。 【0026】(A)成分に対する(B)成分の使用割合 は、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物換 算)に対して(B)成分5~95重量部(完全加水分解

【0024】上記触媒の使用量は、化合物(1)~

縮合物換算)、より好ましくは6~94重量部である。 (A) 成分と(B) 成分の使用割合は目的とする比誘電 率によって変えることが出来るが、(A)成分と(B) 成分の両者を含有することで非常に高い塗膜の弾性率が 得られる。

**15** ...

#### 【0027】(C)成分

本発明の膜形成用組成物は、上記(A)成分と(B)成 分と以下に述べる(D)成分、並びに(C)成分を含有 する。この(C)有機溶媒としては、アルコール系溶 媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒、エステル系溶媒およ び非プロトン系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種が 挙げられる。ととで、アルコール系溶媒としては、メタ ノール、エタノール、nープロパノール、iープロパノ ール、nープタノール、iープタノール、secープタ ノール、tープタノール、nーペンタノール、iーペン タノール、2-メチルプタノール、5 e c - ペンタノー ル、tーペンタノール、3-メトキシブタノール、n-ヘキサノール、2-メチルペンタノール、sec-ヘキ サノール、2-エチルプタノール、5ec-ヘプタノー ル、ヘプタノール-3、n-オクタノール、2-エチル 20 プタンジオンなどのβ-ジケトン類などが挙げられる。 ヘキサノール、sec-オクタノール、n-ノニルアル コール、2、6-ジメチルヘプタノールー4、nーデカ ノール、sec‐ウンデシルアルコール、トリメチルノ ニルアルコール、sec-テトラデシルアルコール、s ecーヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘ キサノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5-トリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、 ジアセトンアルコールなどのモノアルコール系溶媒; 【0028】エチレングリコール、1,2-プロピレン グリコール、1、3-プチレングリコール、ペンタンジ 30 オールー2, 4、2-メチルペンタンジオールー2, 4、ヘキサンジオールー2、5、ヘプタンジオールー 2, 4、2-エチルヘキサンジオール-1, 3、ジエチ レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価ア ルコール系溶媒;エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール モノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシル エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、 エチレングリコールモノ-2-エチルブチルエーテル、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジェチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ ールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ プチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、

ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多 価アルコール部分エーテル系溶媒;などを挙げることが できる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2 種以上を同時に使用してもよい。

【0029】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチル エチルケトン、メチルーnープロピルケトン、メチルー n-ブチルケトン、ジエチルケトン、メチルーi-ブチ ルケトン、メチルー n ーペンチルケトン、エチルー n ー ブチルケトン、メチルーn -ヘキシルケトン、ジー i -ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノ ン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4 ベンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノ ン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2. 4-ヘキサンジオン、2,4-ヘプタンジオン、3,5 ーヘプタンジオン、2,4-オクタンジオン、3,5-オクタンジオン、2、4-ノナンジオン、3、5-ノナ ンジオン、5-メチル-2,4-ヘキサンジオン、2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオン、 1, 1, 1, 5, 5, 5-ヘキサフルオロー2, 4-ヘ これらのケトン系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時 に使用してもよい。

【0030】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、N ーメチルホルムアミド、N、N-ジメチルホルムアミ ド、N-エチルホルムアミド、N、N-ジエチルホルム アミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N. N-ジメチルアセトアミド、N-エチルアセトアミド、 N. N-ジエチルアセトアミド、N-メチルプロピオン アミド、N-メチルピロリドン、N-ホルミルモルホリ ン、Nーホルミルピペリジン、Nーホルミルピロリジ ン、N-アセチルモルホリン、N-アセチルピペリジ ン、N-アセチルピロリジンなどが挙げられる。これら アミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用し てもよい。

【0031】エステル系溶媒としては、ジエチルカーボ ネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、アーブチロラクトン、ア - バレロラクトン、酢酸n - プロピル、酢酸 i - プロピ ル、酢酸nーブチル、酢酸iーブチル、酢酸secーブ 40 チル、酢酸n-ペンチル、酢酸sec-ペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エ チルプチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノー n-ブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ 50 チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ

ーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸n-ブチル、プロピオン酸i-アミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1 10 ン、3,5-オクタンジオン、2,4-ノナンジオン、 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。非プロト ン系溶媒としては、アセトニトリル、ジメチルスルホキ シド、N, N, N´, N´-テトラエチルスルファミ ド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、N-メチルモルホ ロン、N-メチルピロール、N-エチルピロール、N-メチルーΔ3 ーピロリン、Nーメチルピペリジン、Nー エチルピペリジン、N, N-ジメチルピペラジン、N-メチルイミダゾール、N-メチル-4-ピペリドン、N -メチル-2-ピペリドン、N-メチル-2-ピロリド ン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、1,3 -ジメチルテトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノンな どを挙げることができる。

【0032】とれらの有機溶剤の中で、特に下記一般式 (5)で表される有機溶剤が特に好ましい。

R°O (R110), R10  $\cdots (5)$ 

(R'およびR'oは、それぞれ独立して水素原子、炭素 数1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる 1価の有機基を示し、R\*1はアルキレン基を示し、eは 1~2の整数を表す。)

以上の(C)有機溶媒は、1種あるいは2種以上を混合 して使用することができる。本発明の膜形成用組成物 は、(A)成分および(B)成分を構成する化合物 (1)~(3) を加水分解および/または縮合する際 に、同様の溶媒を使用することができる。

【0033】具体的には、化合物(1)~(3)を溶解 させた溶媒中に水または溶媒で希釈した水を断続的ある いは連続的に添加する。との際、触媒は溶媒中に予め添 加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは 分散させておいてもよい。この際の反応温度としては、 通常、0~100℃、好ましくは15~90℃である。 【0034】(D)成分

本発明の膜形成用組成物は(D)水を含有することが特 徴である。一定量の水を含有させることによって、長期 保存しても異物の発生の少ない膜形成用組成物を得るこ とが出来る。(C)成分に対する(D)成分の使用割合 は、(C)成分100重量部に対して(D)成分2~1 5重量部、より好ましくは2.5~12重量部である。

(D) 成分の含有量が2重量部未満であると膜形成用組 成物の長期保存時の異物発生抑制効果が少なく、15重 量部を越えると塗膜の塗布均一性が劣る場合がある。

【0035】その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにβージケ トン、コロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポ リマー、界面活性剤、シランカップリング剤、ラジカル 発生剤、トリアゼン化合物などの成分を添加してもよ

【0036】β-ジケトンとしては、アセチルアセト ン、2、4-ヘキサンジオン、2、4-ヘプタンジオ ン、3,5-ヘプタンジオン、2,4-オクタンジオ 3,5-ノナンジオン、5-メチル-2,4-ヘキサン ジオン、2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプ タンジオン、1, 1, 1, 5, 5, 5-ヘキサフルオロ -2,4-ヘプタンジオンなどを挙げることができ、よ り好ましくはアセチルアセトン、2,4-ヘキサンジオ ン、2,4-ヘプタンジオン、3,5-ヘプタンジオン である。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用し ても良い。

【0037】コロイド状シリカとは、例えば、高純度の 20 無水ケイ酸を前記親水性有機溶媒に分散した分散液であ り、通常、平均粒径が5~30nm、好ましくは10~ 20nm、固形分濃度が10~40重量%程度のもので ある。このような、コロイド状シリカとしては、例え ば、日産化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよ びイソプロパノールシリカゾル; 触媒化成工業(株) 製、オスカルなどが挙げられる。コロイド状アルミナと しては、日産化学工業(株)製のアルミナゾル520、 同100、同200;川研ファインケミカル(株)製の アルミナクリアーゾル、アルミナゾル10、同132な どが挙げられる。有機ポリマーとしては、例えば、糖鎖 構造を有する化合物、ビニルアミド系重合体、(メタ) アクリル系重合体、芳香族ビニル化合物、デンドリマ ー、ポリイミド、ポリアミック酸、ポリアリーレン、ポ リアミド、ポリキノキサリン、ポリオキサジアゾール、 フッ素系重合体、ポリアルキレンオキサイド構造を有す る化合物などを挙げることができる。

【0038】ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 合物としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチ レンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、 40 ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキ シド構造などが挙げられる。具体的には、ポリオキシメ チレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキル エーテル、ポリオキシエテチレンアルキルフェニルエー テル、ポリオキシエチレンステロールエーテル、ポリオ キシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホル マリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレ ンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキ シエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなど のエーテル型化合物、ポリオキシエチレングリセリン脂 50 肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エ

ステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド硫酸 塩などのエーテルエステル型化合物、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、エチレングリコール脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエーテルエステル型化合物などを挙げることができる。ポリオキシチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマーとしては下記のようなブロック構造を有する化合物が挙 10 げられる。

-(X) j - (Y) k -

 $-(X) j - (Y) k - (X) 1 - \cdots$ 

(式中、Xは-CH,CH,O-で表される基を、Yは-CH,CH(CH,)O-で表される基を示し、jは1~90、kは10~99、lは0~90の数を示す)
これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシブロビレンブロックコポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロビレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げることができる。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0039】界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、フッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、ポリ(メタ)アクリレート系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはフッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤を挙げることができる。

【0040】フッ素系界面活性剤としては、例えば1, 1, 2, 2-テトラフロロオクチル(1, 1, 2, 2-テトラフロロプロビル) エーテル、1, 1, 2, 2-テ トラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチレン グリコールジ(1,1,2,2-テトラフロロブチル) エーテル、ヘキサエチレングリコール(1, 1, 2, 2.3.3-ヘキサフロロペンチル) エーテル、オクタ プロピレングリコールジ(1,1,2,2-テトラフロ **・ロブチル) エーテル、ヘキサブロピレングリコールジ** (1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル)エ ーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10 - デカフ ロロドデカン、1、1、2、2、3、3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド) プロピル]-N, N '-ジメチル-N-カルボキ シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ ルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、

パーフルオロアルキル-N-エチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ビス(N-パーフルオロオクチルスルホニル -N-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少 なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオ ロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活 性剤を挙げることができる。また、市販品としてはメガ ファックF142D、同F172、同F173、同F1 83 (以上、大日本インキ化学工業(株)製)、エフト ップEF301、同303、同352(新秋田化成 (株)製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG71 0、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-1 05、同SC-106(旭硝子(株)製)、BM-10 00、BM-1100(裕商(株)製)、NBX-15 ((株)ネオス)などの名称で市販されているフッ素系 界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上 記メガファックF172, BM-1000, BM-11 00, NBX-15が特に好ましい。シリコーン系界面 活性剤としては、例えばSH7PA、SH21PA、S H30PA、ST94PA (いずれも東レ・ダウコーニ ング・シリコーン(株)製などを用いることが出来る。 これらの中でも、上記SH28PA、SH30PAが特 に好ましい。界面活性剤の使用量は、(A)成分(完全 加水分解縮合物) に対して通常 0.0001~10重量 部である。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用

【0041】シランカップリング剤としては、例えば3 – グリシジロキシプロピルトリメトキシシラン、3 – ア ミノグリシジロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリ シジロキシプロピルメチルジメトキシシラン、1-メタ クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミ ノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルト リエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメトキシシ ラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロピルトリメトキ シシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロ ビルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロビルト リメトキシシラン、3-ウレイドプロビルトリエトキシ シラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピル トリメトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、N-トリメトキシシ リルプロピルトリエチレントリアミン、N-トリエトキ シシリルプロピルトリエチレントリアミン、10-トリ メトキシシリルー1, 4, 7-トリアザデカン、10-トリエトキシシリルー1, 4, 7ートリアザデカン、9 - トリメトキシシリル-3,6-ジアザノニルアセテー 50 ト、9-トリエトキシシリル-3,6-ジアザノニルア

しても良い。

セテート、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリメト キシシラン、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリエ トキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリ メトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルト リエトキシシラン、N-ビス (オキシエチレン) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ビス (オキシ エチレン) -3-アミノプロピルトリエトキシシランな どが挙げられる。これらは1種あるいは2種以上を同時 に使用しても良い。

21

リルパーオキサイド、α、α' ビス (ネオデカノイルバ ーオキシ) ジイソプロビルベンゼン、クミルパーオキシ ネオデカノエート、ジーnプロピルパーオキシジカーボ ネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、 1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルバーオキシネオデ カノエート、ビス(4-t-ブチルシクロヘキシル)バ ーオキシジカーボネート、1-シクロヘキシル-1-メ チルエチルパーオキシネオデカノエート、ジー2ーエト キシエチルパーオキシジカーボネート、ジ(2-エチル ヘキシルパーオキシ) ジカーボネート、t -ヘキシルパ 20 ーオキシネオデカノエート、ジメトキブチルパーオキシ ジカーボネート、ジ (3-メチル-3-メトキシブチル パーオキシ) ジカーボネート、t-ブチルパーオキシネ オデカノエート、2、4-ジクロロベンゾイルパーオキ サイド、t‐ヘキシルバーオキシピバレート、t‐ブチ ルパーオキシピバレート、3,5,5-トリメチルヘキ サノイルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイ ド、ラウロイルバーオキサイド、ステアロイルバーオキ サイド、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキ シ2-エチルヘキサノエート、スクシニックパーオキサ 30 ンゼン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフェニ イド、2、5-ジメチル-2、5-ジ(2-エチルヘキ サノイルパーオキシ) ヘキサン、1-シクロヘキシルー 1-メチルエチルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t-ヘキシルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t-ブチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、 m-トルオイルアンドベンゾイルパーオキサイド、ベン ゾイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシイソブチ レート、ジーtープチルパーオキシー2-メチルシクロ ヘキサン、1, 1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1-ビス 40 (t-ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチ ルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキ シ) シクロヘキサン、2,2-ビス(4,4-ジ-t-ブチルパーオキシシクロヘキシル)プロパン、1,1-ビス(t‐ブチルパーオキシ)シクロデカン、t‐ヘキ シルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、t-ブ チルパーオキシマレイン酸、t-ブチルパーオキシー 3, 3, 5-トリメチルヘキサノエート、t-ブチルパ ーオキシラウレート、2、5-ジメチル-2、5-ジ

(m-トルオイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブチルパ ーオキシイソプロピルモノカーボネート、 t ーブチルバ ーオキシ2-エチルヘキシルモノカーボネート、 t-へ キシルパーオキシベンゾエート、2.5-ジメチルー 2. 5-ジ (ベンゾイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブ チルパーオキシアセテート、2,2-ビス(t-ブチル パーオキシ) ブタン、t-ブチルパーオキシベンゾエー ト、n-ブチルー4, 4-ビス(t-ブチルパーオキ シ) パレレート、ジーtーブチルパーオキシイソフタレ 【0042】ラジカル発生剤としては、例えばイソブチ 10 ート、lpha、lpha' ビス(t – ブチルパーオキシ)ジイソブ ロビルベンゼン、ジクミルパーオキサイド、2,5-ジ メチル-2, 5-ジ(t-ブチルパーオキシ) ヘキサ ン、t-ブチルクミルパーオキサイド、ジーt-ブチル パーオキサイド、p-メンタンヒドロパーオキサイド、 2, 5 - ジメチル - 2, 5 - ジ(t - ブチルパーオキシ) ヘキシン-3、ジイソプロビルベンゼンヒドロバー オキサイド、tーブチルトリメチルシリルパーオキサイ ド、1、1、3、3-テトラメチルブチルヒドロバーオ キサイド、クメンヒドロパーオキサイド、t-ヘキシル ヒドロパーオキサイド、tープチルヒドロバーオキサイ ド、2, 3-ジメチル-2, 3-ジフェニルブタン等を挙げることができる。ラジカル発生剤の配合量は、重合 体100重量部に対し、0.1~10重量部が好まし い。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても 良い。

> 【0043】トリアゼン化合物としては、例えば、1、 2-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、 1、3-ビス(3、3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼ ン、1,4-ピス(3,3-ジメチルトリアゼニル)べ ル) エーテル、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフ ェニル) メタン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル フェニル)スルホン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼ ニルフェニル)スルフィド、2,2-ビス〔4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル]-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、 2, 2-ビス〔4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフ ェノキシ)フェニル)プロパン、1,3,5-トリス (3, 3-ジメチルトリアゼニル) ベンゼン、2, 7-ピス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス [4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]フ ルオレン、2, 7-ピス(3, 3-ジメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ビス[3-メチル-4-(3,3-ジメ チルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2,7-ビ ス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス [3-フェニル-4-(3,3-ジメチルトリアゼニ ル) フェニル] フルオレン、2, 7-ビス(3, 3-ジ メチルトリアゼニル) -9, 9-ビス[3-プロペニル -4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]フ 50 ルオレン、2、7ーピス(3、3ージメチルトリアゼニ

ル) -9, 9-ビス[3-フルオロ-4-(3, 3-ジ メチルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス [3,5-ジフルオロー4-(3,3-ジメチルトリア ゼニル) フェニル] フルオレン、2, 7-ビス(3, 3 -ジメチルトリアゼニル) -9, 9-ビス[3-トリフ ルオロメチルー4ー(3,3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フルオレンなどが挙げられる。 これらは1種 あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、 使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃 度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲 となり、保存安定性もより優れるものである。なお、と の全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上 記(B) 有機溶剤による希釈によって行われる。本発明 の組成物を、シリコンウエハ、SiOzウエハ、SiN ウエハなどの基材に塗布する際には、スピンコート、浸 漬法、ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用 いられる。

【0045】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗 りで厚さ0.05~2.5 μm程度、2回塗りでは厚さ 0. 1~5. 0 μm程度の塗膜を形成することができ る。その後、常温で乾燥するか、あるいは80~600 \*C程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥 することにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を 形成することができる。この際の加熱方法としては、ホ ットプレート、オープン、ファーネスなどを使用すると とが出来、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、 アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした 30 減圧下などで行うことができる。また、電子線や紫外線 を照射することによっても塗膜を形成させることができ る。また、上記塗膜の硬化速度を制御するため、必要に 応じて、段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧 などの雰囲気を選択することができる。さらに、本発明 のシリカ系膜の比誘電率は、通常、3.0~1.2、好 ましくは3.0~1.8、さらに好ましくは3.0~ 2.0である。

【0046】とのようにして得られる層間絶縁膜は、低 比誘電率を示し、かつ段差に対する埋め込み性に優れる ことから、LSI、システムLSI、DRAM、SDR AM、RDRAM、D-RDRAMなどの半導体素子用 層間絶縁膜やエッチングストッパー膜、半導体素子の表 面コート膜などの保護膜、多層レジストを用いた半導体 作製工程の中間層、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表 示素子用の保護膜や絶縁膜、エレクトロルミネッセンス 表示素子用の保護膜や絶縁膜などの用途に有用である。 [0047]

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的 に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を 50 石英製セパラブルフラスコ中で、蒸留メチルトリメトキ

**概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載に** より本発明は限定されるものではない。なお、実施例お よび比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞ れ重量部および重量%であることを示している。また、 各種の評価は、次のようにして行なった。

24

## 【0048】重量平均分子量(Mw)

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ ー(GPC)法により測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、加水分 【0044】 このようにして得られる本発明の組成物の 10 解縮合物 1 g を、100 c c のテトラヒドロフランに溶 解して調製した。

> 標準ポリスチレン: 米国プレッシャーケミカル社製の標 準ポリスチレンを使用した。

> 装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマ トグラム (モデル150-C ALC/GPC) カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M

(長さ50cm) 測定温度:40℃

流速:1cc/分

#### 20 【0049】塗膜の比誘電率

8 インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で1分 間、窒素雰囲気200℃で1分間基板を乾燥し、さらに 380℃の真空雰囲気のホットプレートで28分間基板 を焼成した。得られた基板に蒸着法によりアルミニウム 電極バターンを形成させ比誘電率測定用サンプルを作成 した。該サンプルを周波数100kHzの周波数で、横 河・ヒューレットパッカード (株) 製、HP16451 B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメータ を用いてCV法により当該塗膜の比誘電率を測定した。

#### 【0050】塗膜の弾性率

8 インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80°Cで1分 ... 間、窒素雰囲気200℃で1分間基板を乾燥し、さらに 380℃の真空雰囲気のホットプレートで28分間基板 を焼成した。得られた塗膜の弾性率は、ナノインデンタ ーXP(ナノインスツルメント社製)を用いて、連続剛 性測定法により測定した。

### 【0051】ワニス中の異物測定

膜形成用ワニスをO. 1 µm孔径のテフロン (登録商 標) 製カートリッジフィルターも用いて濾過した。この 溶液 1 c c 中に存在する0.2 μ m以上の異物数をR I ON (株) 製パーティクルカウンター、KL-20Aを 用いて測定し、以下の基準で判断した。

: (ワニスを35°C×2ヶ月保存した後の異物数)/ (初期の異物数)≦2

×: (ワニスを35℃×2ヶ月保存した後の異物数)/ (初期の異物数)>2

【0052】合成例1

シシラン77.04gと蒸留テトラメトキシシラン2 4. 05gと蒸留テトラキス(アセチルアセトナート) チタン0.48gを、蒸留プロピレングリコールモノエ チルエーテル290gに溶解させたのち、スリーワンモ ーターで攪拌させ、溶液温度を60°Cに安定させた。次 に、イオン交換水84gを1時間かけて溶液に添加し た。その後、60℃で2時間反応させたのち、蒸留アセ チルアセトン25gを添加し、さらに30分間反応さ せ、反応液を室温まで冷却した。50℃で反応液からメ タノールと水を含む溶液を149gエバボレーションで 10 除去し、反応液Φを得た。とのようにして得られた縮合 物等の重量平均分子量は、8,900であった。

#### 【0053】合成例2

石英製セパラブルフラスコ中で、蒸留メチルトリメトキ シシラン205.50gと蒸留テトラメトキシシラン8 5.51gを、蒸留プロビレングリコールモノメチルエ ーテル426gに溶解させたのち、スリーワンモーター で攪拌させ、溶液温度60℃に安定させた。次に、無水 マレイン酸0.013gを溶解させたイオン交換水18 2gを1時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で 20 2時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。5 0℃で反応液からメタノールを含む溶液を360gエバ ポレーションで除去し、反応液②を得た。とのようにし て得られた縮合物等の重量平均分子量は、1,000で あった。

#### 【0054】合成例3

石英製セパラブルフラスコに、蒸留エタノール470. 9g、イオン交換水226.5gと25%水酸化テトラ メチルアンモニウム水溶液17.2gを入れ、均一に攪 拌した。この溶液にメチルトリメトキシシラン44.9 gとテトラエトキシシラン68.6gの混合物を2時間 かけて添加した。溶液を58℃に保ったまま、6時間反 応を行った。この溶液に20%マレイン酸水溶液80g を添加し、十分攪拌した後、室温まで冷却した。との溶 液にプロピレングリコールモノブロピルエーテル400 gを加え、その後、50℃のエパポレーターを用いて溶米 \*液を10%(完全加水分解縮合物換算)となるまで濃縮 し、その後、マレイン酸の10%プロビレングリコール モノプロピルエーテル溶液10gを添加し、反応液③を 得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分子 量は、990,000であった。

#### 【0055】合成例4

石英製セパラブルフラスコに蒸留エタノール570g、 イオン交換水160gと10%メチルアミン水溶液50 gを入れ、57℃で攪拌を行った。この混合液にメチル トリエトキシシラン15.6gとテトラエトキシシラン 20.9gの混合物を一定速度で1時間かけて添加し た。この溶液を57℃で更に3時間反応させた。この溶 液にプロピレングリコールモノプロピルエーテル300 gを加え、その後、50℃のエパポレーターを用いて溶 液を10%(完全加水分解縮合物換算)となるまで濃縮 した。この溶液10%マレイン酸のプロピレングリコー ル溶液を添加し、溶液のpHを4とすることで反応液の を得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均分 子量は、1,050,000であった。

### 【0056】実施例1

合成例1で得られた反応液Φ45gと合成例3で得られ た反応液340gとイオン交換水2.9gを添加し十分 攪拌した。この溶液を0. 1μm孔径のテフロン製フィ ルターでろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得 られた組成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗 布した。塗膜の比誘電率は2.64と低い比誘電率が得 られ、塗膜の弾性率は8.9GPaと機械的強度に優れ ていた。また、ワニスを保存した後の異物の増加は1. 3倍であり保存安定性に優れていた。

#### 【0057】実施例2~5

実施例1において、反応液のと反応液のの代わりに表1 に示す反応液を使用した以外は実施例1と同様に評価を 行った。評価結果を表1に併せて示す。

[0058]

【表1】

実施	(A)成分		(B)成分		イオン	塗膜比	塗膜	ワニス中の
例					交換水	誘電率	弹性率	異物測定
					(g)		(GPa)	
1	反応被① 4	15g	反応液③	40g	2. 9	2. 64	8. 9	0
2	反応液① 5	50g	反応液③	7g	2. 0	2. 92	10. 4	0
3	反応液② 2	20g	反応液③	60g	1. 5	2. 42	6. 9	0
4	反応液② 2	20g	反応液④	60g	6. 9	2. 46	6. 3	0
5	反応被① 4	15g	反応液④	40g	2. 9	2. 70	8. 5	0

### 【0059】比較例1

合成例1で得られた反応液Φのみを使用した以外は実施 例1と同様にして塗膜の評価を行った。塗膜の比誘電率 50 を保存した後の異物の増加は5.1倍と保存安定性に劣

は2.89と低い値であったが、塗膜の弾性率は3.7 GPaと実施例に比べて劣る値であった。また、ワニス

るものであった。

【0060】比較例2

合成例1で得られた反応液O45gと合成例3で得られ た反応液の40gのみを使用した以外は実施例1と同様 にして塗膜の評価を行った。塗膜の比誘電率は2.67 と低い値であり、塗膜の弾性率も8.2GPaと高い値 であったが、ワニスを保存した後の異物の増加は6.3 倍と保存安定性に劣るものであった。

27

【0061】比較例3

例1と同様にして塗膜の評価を行った。 塗膜の比誘電率 は2.23と低い値であり、ワニスを保存した後の異物\* \*の増加は1.9倍であったが、塗膜の弾性率は4.0G Paと実施例に比べて劣る値であった。

[0062]

【発明の効果】本発明によれば、(A)金属キレート化 合物および/または酸触媒と水の存在下で合成したアル コキシシラン加水分解重合体、(B)アルカリ触媒と水 の存在下で合成したアルコキシシラン加水分解重合体、 (C)有機溶剤、(D)水を含有する膜形成用組成物を 使用することで、低比誘電率、高弾性率を示す塗膜が得 合成例4で得られた反応液Φのみを使用した以外は実施 10 られ、かつワニスを長期保存しても異物の発生の少ない 膜形成用組成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが 可能である。

#### フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

C O 9 D 183/14 HO1L 21/312

21/316

(72)発明者 塩田 淳

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ

スアール株式会社内

(72)発明者 西川 通則

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ

スアール株式会社内

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号ジェイエ

スアール株式会社内

FΙ

ターマコード(参考)

C 0 9 D 183/14

HO1L 21/312

С

21/316

G

Fターム(参考) 4D075 BB26Z CA03 CA23 DA06

DB14 DC19 DC22 EA06 EA07 EB16 EB33 EB43 EB47 EB56

EC01 EC07 EC08 EC30 EC54

4J002 CP031 CP032 CP081 CQ05

HA07

4J038 DL021 DL022 DL031 DL032

DL051 DL052 DL071 DL072

DL081 DL082 DL111 HA156

JA17 JA26 JA33 JA34 JA53 JB13 KA06 NA17 NA21 NA26

PA18 PA19 PB07

5F058 AC03 BC02 BF46 BH01 BJ02